



**RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVIES**  
*Secretario General y*  
*del Consejo de Administración*  
**TELEFÓNICA, S.A.**

TELEFÓNICA, S.A. de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente

### **HECHO RELEVANTE**

TELEFÓNICA, S.A., a través de su filial TELEFÓNICA EMISIONES, S.A.U. realizó en el día de ayer, al amparo de su programa de emisión de deuda registrado en la *Securities and Exchange Commission (SEC)* de los Estados Unidos el 22 de mayo de 2012, una emisión de Bonos (*Notes*) con la garantía de TELEFÓNICA, S.A. por un importe agregado de 2.000 millones de dólares americanos.

Esta emisión se divide en dos tramos: el primero de ellos, por un importe de 1.250 millones de dólares americanos, con vencimiento el 27 de abril de 2018, con cupón del 3,192 %, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par. El segundo de ellos, por un importe de 750 millones de dólares americanos, con vencimiento el 27 de abril de 2023, con cupón del 4,57 %, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.

El desembolso de esta emisión está previsto que se realice el 29 de abril de 2013.

En Madrid, a 18 de abril de 2013.

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**  
**- MADRID -**